

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司

2022 年度持续督导跟踪报告

2019 年 7 月 22 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“公司”）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为安集科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责安集科技上市后的持续督导工作，持续督导期为 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日。

2022 年度（以下简称“报告期”），保荐机构对安集科技的持续督导工作情况总结如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	完成或督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并制定了相应工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与安集科技签订了保荐协议（明确双方在持续督导期间的权利义务）
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度持续督导期间，公司未发生需按有关规定公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等	2022 年度持续督导期间，安集科技及相关当事人不存在违法违规和违背承诺的情况

	事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2022 年度持续督导期间，安集科技及其董事、监事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	公司章程、三会议事规则等制度符合相关法规要求，持续督导期间，公司有效执行了相关治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	安集科技内控制度符合相关法规要求，可以保证公司的规范运行，督促公司严格执行内部控制制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	公司已按照证券监管部门的相关要求建立了信息披露制度。2022 年度持续督导期间，安集科技向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	2022 年度持续督导期间，保荐机构对安集科技的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公司给予了积极配合。截至本报告签署日，不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	在 2022 年持续督导期间，安集科技或其控股股东、董事、监事、高级管理人员人员未发生受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022 年度持续督导期间，安集科技及控股股东不存在未履行承诺的情况

13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022 年度持续督导期间，未发现安集科技该等事项
14	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年度持续督导期间，安集科技未发生该等情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求；2023 年 1 月 9 日-2023 年 1 月 17 日对公司进行了持续督导现场检查
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2022 年度持续督导期间，安集科技未发生该等情况
17	持续关注上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	2022 年持续督导期间，保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查意见

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、产品开发风险

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于产品技术创新要求较高。在下游产品不断提出更高技术要求的前提下，对上游关键半导体材料的要求也在不断提高，公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发满足客户需求的产品。如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在产品开发方向的战略决策上出现失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将使得公司产品开发的成功率受到影响，持续大量的研发投入成本无法回收，进而对公司经营造成不利影响。

（二）经营风险

1、客户集中度较高风险

2020 年度、2021 年度和 2022 年，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.99%、84.45%和 82.47%。公司销售较为集中的主要原因系国内外集成电路制造行业本身集中度较高、公司产品定位领先技术的特点和“本土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国内外领先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各种原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调产品价格，公司的经营业绩可能出现下降。

2、原材料供应及价格上涨风险

硅溶胶和气相二氧化硅等研磨颗粒为公司生产化学机械抛光液所需的重要原材料，主要直接或间接从日本等国家进口。2020 年度、2021 年度和 2022 年，公司向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比分别为 53.21%、51.27%和 52.81%，采购相对集中。如果公司主要供应商的供货条款发生重大调整或者停产、交付能力下降、供应中断等，或者进出口政策出现重大变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国采取出口管制，或者公司主要原材料价格受市场影响出现上升，将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，公司主要从上游基础化工或精细化工行业采购原材料，随着环保政策趋严，供应趋紧，原材料价格可能存在上涨的风险。

（三）财务风险

1、汇率波动风险

公司销售商品、进口原材料中使用美元结算的比例较大。2020 年度、2021 年度和 2022 年，受人民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损益（收益以“-”列示）的金额分别为 732.97 万元、580.71 万元和-3,171.68 万元。随着生产、销售规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格仍将直接受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。

2、交易性金融资产公允价值变动风险

青岛聚源系公司于 2020 年以自有资金认缴出资 1 亿元与其他投资方共同设立，作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票，公司将持有青岛聚源的合伙份额在报告期末按公允价值计入交易性金融资产，具体金额受中芯国际股价波动影响。如果未来公司对外投资的交易性金融资产的公允价值产生波动，将会对公司的经营业绩产生影响。

（四）行业风险

1、半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。中国集成电路产业在下游市场的推动以及政府与资本市场的刺激下，获得了强大的发展动力。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导体行业市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司经营业绩产生不利影响。

（五）宏观环境风险

1、全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险

当前全球经济处于周期性波动当中，受到全球政治环境不稳定等因素的影响，尚未出现经济全面复苏的趋势，面临下滑的可能。随着全球主要经济体经济增速放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下游客户需求或者订单量产生不利波动，进而影响公司业绩。此外，如果发生自然灾害、战争或其他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下游市场及公司经营业绩造成影响。

四、重大违规事项

2022 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,076,787,316.10	686,660,621.16	56.82
归属于上市公司股东的净利润	301,436,958.70	125,084,063.28	140.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,453,800.14	91,107,538.21	229.78
经营活动产生的现金流量净额	239,122,116.48	61,105,784.69	291.32
主要会计数据	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,521,549,944.38	1,201,160,935.33	26.67
总资产	2,047,601,294.07	1,672,228,439.94	22.45

2022 年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	4.59	2.35	95.32
稀释每股收益（元 / 股）	4.58	2.35	94.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	4.57	1.71	167.25
加权平均净资产收益率（%）	22.20	11.11	增加 11.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平	22.12	8.10	增加 14.02 个百分点

均净资产收益率（%）			
研发投入占营业收入的比例（%）	14.99	22.30	减少 7.31 个百分点

2022 年度，公司营业收入实现同比增长 56.82%，主要原因为：在“立足中国，服务全球”的战略定位下，公司持续保持与现有客户积极紧密合作，加大力度开拓中国大陆地区市场，客户用量及客户数量进一步上升，同时海外市场进一步拓展，公司营业收入稳步提升。在化学机械抛光液方面，公司积极推进化学机械抛光液全品类产品的市场拓展和客户端导入进程，其中钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液及衬底抛光液的产品布局进一步丰富且营业收入增长率较高，硅衬底抛光液在海外市场有突破性进展；在功能性湿电子化学品方面，公司持续攻克技术难关，中国大陆市场的拓展按计划顺利进行，新产品成功导入海外市场，功能性湿电子化学品的营业收入情况如预期；在电镀液及添加剂方面，公司在自身研发积累搭建技术平台的基础上，通过进一步技术引进等横向合作的形式，进一步拓展和加强了产品线平台能力建设，提升了公司在该领域的综合水平，且大幅度加速了规模量产的进程，产品已覆盖多种电镀液及添加剂。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 30,045.38 万元，较去年同期增长 229.78%，主要系公司与客户紧密合作，充分把握客户需求，持续加大产品研发和产品商业化的多方位布局，同时，公司持续提升管理和运营效率，使得公司业绩积极增长。

归属于上市公司股东的净利润为 30,143.70 万元，较去年同期增长 140.99%，除归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变动影响以外，公司存在计入当期损益的政府补助，同时对外投资的公允价值变动与投资收益为负，使得非经常性损益项目合计金额较小，因此扣除非经常性损益后净利润与净利润差异不大。

经营活动产生的现金流量净额为 23,912.21 万元，较去年同期增长 291.32%，主要系销售回款增长等所致。

归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年分别增长 26.67%和 22.45%，主要系公司 2022 年度经营积累所致。

基本每股收益和稀释每股收益较上期增加 95.32%和 94.89%，主要系公司净利润增加所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增长 167.25%，主要系公司扣除非经常性损益的净利润上升所致。

综上，公司 2022 年度主要财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

2022 年度，公司核心竞争力未发生不利变化。公司核心竞争力体现在：

（一）深耕高端半导体材料领域

公司自成立之初就将自己定位为高端半导体材料领域的一站式合作伙伴，率先选择技术难度高、研发难度大的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，深耕现有技术平台，聚焦电镀液及添加剂高端产品系列国产突破。公司持续专注投入，已成功打破了国外厂商的垄断并已成为众多半导体行业领先客户的主流供应商。

公司通过多年持续投入，已拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，成熟并广泛应用于公司产品中。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有授权发明专利 250 项。同时，公司持续加强知识产权管理，依照国家《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）制订了完善的知识产权管理体系，并通过了国家知识产权管理体系认证。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术，持续创新并更新知识产权库，实现产品和技术的差异化，为公司开发新产品和开拓新业务创造了有利条件。

未来，公司将凭借在高端半导体材料领域积累的宝贵经验持续深耕，依托已有的先进技术平台和人才团队为客户提供高附加值的产品和服务。

（二）持续的研发投入和高效的产品转化

公司持续投入大量的资金、人力等研发资源，将重点聚焦在产品创新上，以满足下游制造和封测行业全球领先客户的尖端产品应用，已成为国内高端半导体材料行业领域的领先供应商。

公司致力于为集成电路产业提供以创新驱动的、高性能并具成本优势的产品和技术解决方案，从解决方案设计、产品研发、测试认证、供应保障、物流配套、技术支持等方面着手，提供全生命周期、全价值链的一站式服务。得益于有竞争力的商业模式，公司产品研发效率高且具有针对性。公司利用在化学配方、材料科学等领域的专长，持续研发创新产品或改进产品以满足下游技术先进客户的需求，将客户面临的具体挑战转化成现实的产品和可行的工艺解决方案。

（三）国际化、多元化的人才储备

通过多年的集成电路制造及先进封装领域的研发时间，公司组建了一批高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队。核心技术团队均由资深行业专家组成，在化学、材料化学、材料工程等专业领域有着长达几十年的研究经验，并在半导体材料行业深耕积累了数十年的丰富经验和先进技术。公司核心管理团队也在战略规划、行业发展、人才培养、团队建设、销售与市场、跨国公司管理等方面拥有丰富经验。公司管理团队在半导体材料及相关行业的丰富经验为公司的业务发展带来了全球先进乃至领先的视角。公司高素质的员工队伍为维持竞争优势提供了保证。

与此同时，公司持续加大后备人才引进和培养，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力。团队规模逐渐扩大的同时，团队能力培养初见成效，公司加大培训投入，在识别和分析公司人才需求的基础上，针对性地组织内外部培训、研讨交流会、知识分享会，始终贯彻了“终生学习”的理念，构建了结构化、多元化、体系化的学院式培训，有效提升员工的综合素质能力。

（四）贴近市场和客户的服务模式

公司根植于全球半导体材料的第一大和第二大市场，布局富有经验的应用工程师团队在当地提供 24 小时服务。根据 SEMI，2021 年中国台湾半导体材料市场规模同比增长 15.7%，达到 147.1 亿美元，继续位居全球第一；中国大陆半导体材料市场规模同比增长 21.9%，成为 2021 年增长最快的地区，达到 119.3 亿美元。贴近市场和客户的服务模式有利于公司及时响应客户需求，运输时间短，运输成本低，并且与本土客户文化融合程度高，沟通效率高，具有较强的灵活性。

（五）成熟高效的全流程质量保证体系

公司秉承“客户至上、质量导向、持续创新、全面可靠”的质量方针，致力于满足并超越客户的期望。公司围绕产品导入的全流程建立了成熟有效的产品质量保证体系，在产品研发、供应商管理、进料控制、过程控制、出货控制、客户服务、产品优化和迭代等方面进行全流程质量管控并已通过 ISO9001, ISO14001, ISO45001 等管理体系的第三方认证。

（六）成熟高效的全流程质量保证体系

公司始终秉承“使命必达”的工作态度和服务宗旨，以高标准、严要求建立健全了以内部控制为中心的一系列政策体系、管理流程和机制，以全面防范应对各项风险危机。结合公司管理机制，管理团队从国际环境、客户需求等多角度预测，提前部署应对突发事件的准备工作，在人员、物资、原材料及供应链保障等方面制定多项应对方案及工作计划表，进一步保障公司日常生产运营的有序进行。报告期内，在大环境不确定的情况下，仍以高效、积极状态推进公司生产、运营高质量发展，公司各项业务有序推进的同时，重大建设项目也按预期完成交付。

七、研发支出变化及研发进展

公司 2022 年持续加大研发投入和创新力度。2022 年度，公司研发费用为 161,364,582.09 元，与 2021 年度相比增长 5.39%；研发费用占营业收入的比重为 14.99%，与 2021 年度相比有所下降。

公司始终秉承“研发创新驱动企业发展”的理念，持续研发投入，不断提升研发创新能力，加大市场开拓力度。公司围绕液体与固体衬底表面的微观处理技术，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，成功搭建三大具有核心竞争力的技术平台：化学机械抛光液-全品类产品矩阵、功能性湿电子化学品-领先技术节点多产品线布局、电镀液及其添加剂-实现电镀高端产品系列国产突破。

公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。报告期内，公司化学机械抛光液全品类产品矩阵布局进一步加强：铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液及新应用的化学机械抛光液等各类产品线的研发进程及市场拓展顺利，客户用量及客户数量均达到预期。

在铜及铜阻挡层抛光液方面，公司紧跟摩尔定律，紧跟行业领先客户的先进制程，提前进行技术平台的布局及技术能力的积累，持续推进相关产品的研发，持续优化先进技术节点产品的性能及稳定性，部分领先技术产品在重要客户端完成发布；与成熟制程芯片制造厂保持紧密合作，持续改进成熟技术节点的产品，为量产做好准备。

在介电材料抛光液方面，公司持续开发及优化氮化硅抛光液。报告期内，公司首款氮化硅抛光液通过客户验证并量产销售，实现商业化，使国内具备氮化硅

抛光液产品自主供应能力，同时也进一步提升了公司的介电材料抛光液产品平台的竞争力。

公司钨抛光液在逻辑芯片和存储芯片领域的应用范围 and 市场份额持续上升，钨抛光液产品在逻辑芯片先进技术节点通过验证并实现销售，多款产品在逻辑芯片成熟制程和先进制程进行测试验证，进展顺利。

公司与客户紧密合作，共同开发的基于氧化铈磨料的抛光液产品突破技术瓶颈，目前已在 3D NAND 先进制程中实现量产并在逐步上量；报告期内，基于氧化铈磨料的抛光液在国内领先的存储客户持续突破，多款新产品完成论证测试并实现量产销售，部分产品已成为主流，国产自主供应能力持续加强。

在衬底抛光液方面，公司紧跟国内大硅片企业的发展和打造材料自主可控能力的趋势，充分了解客户的需求后定制化开发抛光液产品。报告期内，公司研发的硅精抛液取得突破，技术性能达到国际先进水平，并在国内领先硅片生产厂完成论证并实现量产，营业收入增长明显，部分产品已获得中国台湾客户的订单。第三代半导体作为下一代的衬底材料同样发展迅速，公司积极投入研发，为客户定制开发的用于第三代半导体衬底材料的抛光液，进展顺利，部分产品已获得海外客户的订单。

公司在功能性湿电子化学品领域，致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案，并持续拓展产品线布局，目前已涵盖刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液及刻蚀液等多种产品系列。报告期内，公司在碱性铜抛光后清洗液取得重要突破，在客户先进技术节点验证进展顺利，进入量产阶段，进一步完善了公司抛光后清洗液产品平台。

电镀是集成电路制造关键工艺，电镀液及其添加剂是实现电镀技术的关键材料，集成电路用电镀液在技术指标、研发难度、认证周期等方面要求极高，属于电镀领域的高端产品。在集成电路制造及先进封装中，电镀广泛应用于集成电路制造大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、先进封装凸点工艺（bump）以及再分布线（RDL）工艺，实现金属互联。通过充分的市场调研和技术探索，并结合下游客户的需求、国内相关领域技术进程及公司现有的技术平台，公司在报告期内完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，并且在自有技术持续开发的基础上，通过技术引进等形式，进一步拓展

和强化了平台建设，提升了公司在相关领域的技术水平，研发产品已覆盖多种电镀液添加剂，多种电镀液添加剂在先进封装领域已进入客户量产导入阶段。电镀液及添加剂系列产品的布局，是公司在横向拓展产品平台的重大迈步，开启市场新征程的同时，进一步助力国内半导体制造用关键材料自主可控供应能力的提升。

至此，公司技术及产品已涵盖集成电路制造中“抛光、清洗、沉积”三大关键工艺。随着公司研发产品范围及应用的进一步拓展，应用逐渐覆盖芯片制造中成熟制程及特殊制程多个技术节点，在先进封装领域的产品覆盖面也越来越广，客户数量得到进一步提升。

与此同时，公司持续加快建立核心原材料自主可控供应的能力，以优化产品性能及成本结构，提升现有产品竞争力，保障长期供应的可靠性，并在研究中寻求开发新产品的技术可行性。报告期内，参股公司山东安特纳米材料有限公司开发的多款硅溶胶已在公司多款抛光液产品中通过内部测试，并在积极与客户合作进行测试验证中，部分已完成验证，开启量产阶段；同时，公司通过自研自建的方式持续加强了氧化铈颗粒的制备和抛光性能的自主可控能力，进展顺利，目前已完成中试验证，正在进行规模化量产能力建设。公司通过自建、合作等多种方式，加强产品及原料的自主可控，并已取得突破性进展，部分关键原材料成功已实现量产。

公司持续投入大量资金、人力等研发资源，夯实现有研发平台能力建设，把握产品迭代更新，不断提高研发成果转化效率，公司产品的应用能力和延展能力得到进一步提升。公司坚持研发创新的同时，不断完善自主知识产权的布局，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司共获得 250 项发明专利授权，其中中国大陆 190 项、中国台湾 50 项、美国 5 项、新加坡 3 项、韩国 2 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金余额为人民币 176,163,219.00 元。具体情况如下表：

单位：元

项目	金额
实际收到募集资金	483,927,759.01
减：募投项目累计使用金额	319,573,073.82
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款	257,605,325.38
超募资金永久补充流动资金	48,428,548.77
节余募集资金永久补充流动资金	2,263,328.93
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	3,335,522.68
减：支付的其他发行费用	5,700,334.53
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	20,844,391.02
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	176,163,219.00

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东 Anji Microelectronics Co., Ltd. 直接持有公司股票 28,144,459 股，所持股份不存在质押、冻结的情况。2022 年度公司控股股东出于自身资金需求以询价转让方式减持了公司股份。公司无实际控制人。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	持有公司的权益比例（%）	2022 年度质押、冻结及减持情况
1	Shumin Wang	董事长、总	9.67	高管战略配售减持及

序号	姓名	职务	持有公司的权益比例（%）	2022 年度质押、冻结及减持情况
		经理		Anji Cayman 减持致使间接持股变动
2	Chris Chang Yu	董事	2.47	Anji Cayman 减持致使间接持股变动
3	朱沛文	董事	-	-
4	陈大同（离任）	董事	0.03	Anji Cayman 减持致使间接持股变动
5	杨磊	董事	-	-
6	郝一阳	董事	-	-
7	张天西	独立董事	-	-
8	李华	独立董事	-	-
9	任亦樵	独立董事	-	-
10	高琦	监事	-	-
11	陈智斌	监事	-	-
12	冯倩	监事会主席、职工代表监事	-	-
13	Zhang Ming	副总经理、财务总监	0.03	-
14	Yuchun Wang	副总经理	0.18	高管战略配售减持致使间接持股变动
15	杨逊	副总经理、董事会秘书	0.47	高管战略配售减持及安续投资减持致使间接持股变动

十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


包建祥


康 杰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

